



厚膜印刷基板ご使用上の注意事項

1. ご使用上の注意

- (1) 導体表面を直接素手で触れると、導体に変色したり、腐食する場合がございます。お取扱時はきれいな保護手袋等を着用し、直接素手で触れないようにお願いします。
- (2) 基板の角部及び分割後のバリ等により手指を切傷する恐れが有りますので、お取扱時は保護手袋等を着用し、素手で直接触れないようにして下さい。
- (3) テストプローブなどで導体膜へのキズ等による膜剥がれ、W/B密着性劣化を誘発する可能性がありますので、電氣的チェック時は注意願います。
- (4) 基板サイズ、板厚などによって、リフロー条件、はんだ付け性に影響を及ぼす事もございますので、十分ご確認の上ご使用下さい。
- (5) 製品を外装樹脂にてコーティングされる場合には、熱膨張係数、吸湿影響度、セット後の使用環境は十分ご確認の上ご使用下さい。
- (6) 外装無しでご使用なさる際には、結露、腐食性ガスなどによる影響には十分ご配慮願います。
- (7) 実装の際にメカチャック、バックアップピン等の影響で分割ライン部から割れ、破損することがございます。従って、ライン部へのメカチャック、バックアップピンは避けてセットお願い致します。
- (8) 塩素系洗浄剤などは洗浄残渣による不具合が発生する可能性がありますので、使用はお避け下さい。
- (9) 製品及び梱包材の廃棄については、排出事業者自らが適性に処理することを定めた法律や条例がありますので、それらの法律を遵守して下さい。

2. 製品保管上の注意

- (1) 保管は常温・常湿（ $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ 、 $60 \pm 10\% \text{R. H}$ ）で清浄な状態に保たれる様お願い致します。又、古いロットからご使用をお願い致します。
- (2) 導体は蛍光灯（ハロゲン）などでの変色、或いは長期保管での硫化、酸化も懸念されます。開梱後には直射日光並びに、袋から出し大気に長期触れることは避け、真空パック等の処理を施して下さい。
- (3) 保管される場合には製品を損傷させる原因となりますので、荷重が加わらない様にご配慮願います。

3. その他

- (1) フェイルセーフ機能が必要な場合には、引き合い、設計段階で予め調整させて下さい。
- (2) 当製品をきわめて高い信頼性が要求される用途でご使用される場合には、予め当社販売窓口までご相談下さい。【車載機器（自動車、車両）、船舶、航空、宇宙機器、医療機器等】